

MagicResin[®] Sheet

MagicResin[®] Sheet

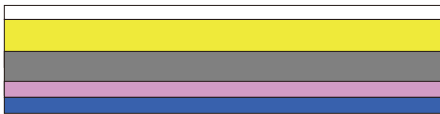
Selective MagicResin[®] on needed Area






Features

- MagicResin[®] with heat resistant adhesive. Attachable on your carrier.
- **Easy cut by scissors, cutter.**
- Adhesive enable to attach sheet on desired area. Reduce cost.
- Attachable on your existing carrier. No need to waste your property.

Spec

- Sheet size: 495 × 295mm / Effective resin area: 430 × 260 mm



	Protection film(PET)
	MagicResin [®] 0.1t or 0.2t
	Heat resistant Glass epoxy 0.1t or 0.3t
	Heat Resistant adhesive 0.05t
	Back sheet

MagicResin[®] Sheet Line up

Type	Thickness
MagicResin [®] Sheet Type-K100S	0.25t, 0.45t
MagicResin [®] Sheet Type-K200S	0.35t, 0.55t
MagicResin [®] Sheet Type-T100M	0.25t, 0.45t
MagicResin [®] Sheet Type-T200M	0.35t, 0.55t
MagicResin [®] Sheet Type-T100S	0.25t, 0.45t
MagicResin [®] Sheet Type-T200S	0.35t, 0.55t

※Please contact, incase desired thickness is not shown above.

Inquiry

Daisho Denshi Co.,Ltd. <http://www.daisho-denshi.co.jp/>

Tochigi No.2 Plant: 1567-23, Kiwada-jima, Nikko-shi, 321-2345 Tochigi, Japan

TEL : 0288-26-5831 e-mail : daisan@daisho-denshi.co.jp

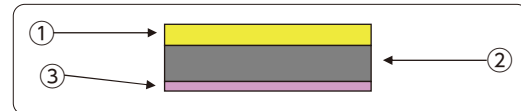
マゾックレジジン and *MagicResin** are registered trade marks of Daisho Denshi Co.,Ltd.
Daisho Denshi owns the intellectual property of MagicResin[®].



How to use MagicResin[®] sheet

1. MagicResin[®] sheet construction

- ① MagicResin[®]: Silicone resin 0.1 or 0.2t
- ② Base Material: High heat resistant black glass epoxy / 0.1 or 0.3t
- ③ Adhesive Tape: Heat resistant double sided tape(Acryl) 0.05t



2. How to use (Important tips)

- 1) Cut MagicResin[®] sheet into desired shape.
*MagicResin[®] sheet can be easily cut by scissors, cutter, or punching.
- 2) Remove back sheet(white color), which covers adhesive tape surface.
- 3) Attach MagicResin[®] sheet on desired area of base carrier.
*Avoid direct resin contact to terminal. Otherwise, low molecular weight siloxane may cause electrical failure. (Remain as dielectric substance)
*Avoid direct resin contact to tape area, resin coating, ink area. May cause weak adhesion of tape, resin and ink repel due to low molecular weight siloxane. (Remain as dielectric and repel substances.)
*No air trap between base carrier and MagicResin[®] sheet is preferred.
- 4) Remove protection film covering MagicResin[®] surface.
- 5) To reduce low molecular weight siloxane, run MagicResin[®] sheet attached base carrier to reflow 2 ~ 3 times.
- 6) Clean MagicResin[®] sheet surface by IPA, ethanol, acetone, etc.
- 7) Use as usual as conventional MagicResin[®].
*Use as usual means attach board onto MagicResin[®] and run assembly process.
- 8) Operation temperature 240degC. 100 cycles.
*Conventional reflow.

3. Important tip for base carrier selection

If base carrier condition falls into below, air bubble may appear between base carrier and MagicResin[®] sheet, and cause low performance.

- 1) If base carrier have less surface smoothness.
- 2) If base carrier is organic material base.(Including black anodized alminum)

4. Recommended construction

Unprocessed metal surface is recommended as base carrier.

5. Maintenance

- 1) Wet natural fiber with IPA, ethanol or acetone, and wipe resin surface gently.
- 2) Remove dust on resin surface using sticky roller.

MagicResin® Sheet

マジックレジン®シート

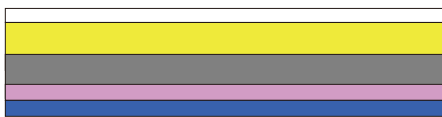
必要な部分にマジックレジン®を貼り付け

特徴

- マジックレジン®に耐熱性粘着剤をプラス。キャリアに貼り付けて使用出来ます。
- はさみやカッターで簡単にカットできます。
- 粘着剤が付いている為、必要な箇所に任意で貼付けが出来、コストダウンが可能。
- 今、お使いのキャリアに貼付け可能。現在の資産を無駄にしません。

製品基本仕様

- 外形サイズ：495×295mm / 有効サイズ：430×260mm



保護フィルム (PET)
マジックレジン®樹脂 0.1t、0.2t
耐熱ガラエポ材 0.1t、0.3t
耐熱粘着剤 0.05t
離形紙

マジックレジン®シート種類

種類	総厚
MagicResin® Sheet Type-K100S	0.25t、0.45t
MagicResin® Sheet Type-K200S	0.35t、0.55t
MagicResin® Sheet Type-T100M	0.25t、0.45t
MagicResin® Sheet Type-T200M	0.35t、0.55t
MagicResin® Sheet Type-T100S	0.25t、0.45t
MagicResin® Sheet Type-T200S	0.35t、0.55t

※上記以外の厚みをご希望の場合はご相談下さい。

お問い合わせ

株式会社 大昌電子 <http://www.daisho-denshi.co.jp/>
栃木第二工場 〒321-2345 栃木県日光市木和田島 1567-23
TEL: 0288-26-5831 e-mail: daisan@daisho-denshi.co.jp

※マジックレジン®および MasicResin®は(株)大昌電子の登録商標です。
※(株)大昌電子はマジックレジン®に関する知的所有権を有しています。



マジックレジン®シート使用方法について

1. マジックレジン®シート構成

- ① マジックレジン®樹脂：シリコーン樹脂 0.1 又は 0.2 t
- ② ベース材料：高耐熱黒色ガラスエポキシ材 / 0.1 t 又は 0.3 t
- ③ 接着テープ：耐熱両面テープ(アクリル) 0.05 t



2. 取り扱い方法 (※に注意事項を示す)

- 1) マジックレジン®シートを必要な形状にカットする。
*マジックレジン®シートのカット方法は、カッター、はさみ、簡易金型等で用意に行えます。
- 2) マジックレジン®シート粘着テープ表面を覆う離形紙(白色)を剥がす。
- 3) ベースキャリア材料の任意の位置にマジックレジン®シートを貼り付ける。
*接続端子部へ直接接触をさせないでください。低分子量シロキサンの影響により電気的不具合を引き起こす可能性があります。(絶縁性物質としての残渣)
*テープ貼り・樹脂塗布・インク捺印がなされる場所へ直接接触させないで下さい。低分子量シロキサンの影響により、テープの接着性低下や樹脂の接着性の低下、インク弾きを引き起こす可能性があります。(離型性・撥水性物質としての残渣)
*この時、ベースキャリア材料とマジックレジン®シートの界面にエア残渣のないことが望ましい。
- 4) マジックレジン®樹脂の表面を保護するフィルムを剥がす。
- 5) 低分子量シロキサンの低減処理としてマジックレジン®シートを貼付けたキャリアをリフロー炉へ2から3回通す。
- 6) マジックレジン®樹脂表面をIPA・エタノール等で表面を拭く。
- 7) 従来のマジックレジン®と同様に使用する。
*従来のマジックレジン®の使用法とは、マジックレジン®を利用し基板を密着保持させ実装工程へ流すことを言う。
- 8) 使用温度：240℃前後 使用回数：100回程度
*一般リフロー炉対応

3. ベースキャリア選定における注意事項

ベースキャリア材が下記状態の場合、リフロー時にベースキャリア材とマジックレジン®シートの界面にエアが発生し、表面平滑度が劣りご使用が困難となる場合があります。

- 1) ベースキャリア材料の表面平滑度が劣る場合。
- 2) ベースキャリア材料が有機系の材質の場合。(アルミ黒アルマイト処理等も含む)

4. 推奨構成

ご使用いただくベースキャリア材は金属表面無処理材をご推奨いたします。

5. メンテナンス方法

- 1) IPA・エタノール等を天然繊維(ベンコット)に十分しみこませ、表面をなでるように拭き取り洗浄を行う。
- 2) 粘着ローラー等を使用し、マジックレジン®樹脂表面の塵埃を除去する。